

Presse-Information

Modulare Gehäuseoberteile für individuelle Gerätekonzeppte

(03/16) Phoenix Contact erweitert die Gehäuseserie BC um neue modulare Oberteile. Die Seitenwände der Oberteile sind in drei unterschiedlichen Varianten ausgeführt und erlauben so flexible Leiterplatten-Layouts.

Anwender können einzelne Segmente individuell konfigurieren und die Leiterplatten-Anschlusstechnik und Bestückungsfläche der Leiterplatte an ihre Applikation anpassen. Die Polycarbonatgehäuse stehen in den Baubreiten 71,6 mm und 107,6 mm zur Verfügung und bieten eine große Frontfläche zur Beschriftung und Markierung der Funktionseinheiten.

4827

Bitte bei Kennziffer-Veröffentlichungen für die Leserdienst
Zuordnung angeben